

“首届全球 IC 企业家大会暨 IC China2018”

12 月 11 日在上海举办



由工业和信息化部、上海市人民政府指导，中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办，北京赛迪会展有限公司、中国电子报社、上海市集成电路行业协会承办的“首届全球 IC 企业家大会暨第十六届中国半导体博览会(IC China2018)”将于 12 月 11 日—13 日在上海浦东嘉里大酒店(会议)、上海新国际博览中心(展览)举办。

本次大会以“开放发展、合作共赢”为主题，来自中国、美国、德国、英国、法国、荷兰、日本、韩国以及中国台湾等十多个国家和地区的企业家将齐聚上海，共享发展成果，共商发展大计。200 多家国内外企业参加展览，展示最新成果，开拓市场商机。

全球企业家汇聚，共商发展大计

今年是集成电路发明 60 周年。作为电子信息产业的基础，集成电路技术的创新和应用，改变着人们的生产方式和生活方式。随着摩尔定律不断

向前演进，全球集成电路产业面临技术变革期。如何把握集成电路的技术演进路线，如何抓住互联网、大数据、人工智能蓬勃发展的巨大市场，如何抓住中国进一步改革开放的历史机遇，实现新增长？是全球集成电路产业必须面对的重大课题。

多家半导体行业协会组织的负责人士将出席本次大会。中国半导体行业协会理事长、中芯国际集成电路制造有限公司董事长周子学，美国半导体行业协会轮值主席、Marvell 公司总裁兼首席执行官 Matt Murphy，美国半导体行业协会副总裁 Jimmy Goodrich，韩国半导体产业协会 CEO Nam Kiman，日本半导体行业协会副会长 Tetsuya KITAGAWA 等将共同探讨新形势下产业合作发展的新路径。

国际半导体设备与材料协会全球总裁兼首席执行官 Ajit Manocha，RISC-V 基金会主席 Krste Asanovic 等半导体产业热点领域的行业协会负责人士也将分享他们的创新成果和应用。

出席本次大会的企业演讲嘉宾阵容强大，Cadence 公司 CEO 陈立武、美国高通公司中国区董事长孟樸、英飞凌科技公司大中华区总裁苏华、Arm 中国执行董事长兼 CEO 吴雄昂、三星电子有限责任公司执行副总裁 Greg Yang、瑞萨电子株式会社高级副总裁、瑞萨电子中国区董事长真冈朋光、紫光集团有限公司董事长赵伟国、华润微电子有限公司常务副董事长陈南翔、武岳峰资本创始合伙人武平……充分体现了本次大会的国际化、高端化、专业化特征。

搭建专业化平台，推动技术落地

本次大会除一场主论坛外，组委会还精心组织了六场分论坛。分论坛突出专业、专注特色，为新技术、新产品落地、产业链协同合作搭建平台。

“集成电路设计技术与创新论坛”由中国半导体行业协会设计分会承办，超威半导体、Cadence、新思科技、深鉴科技、豪威科技、紫光展锐等业界领先的设计企业将集中分享 IC 设计的新方案。

“先进封装技术创新论坛”由中国半导体行业协会封装分会承办，来自长电科技、华天科技、通富微电、晶方半导体、华进半导体等国内封装龙头企业，将探讨集成电路领域先进封装技术的发展趋势。

“集成电路产业链创新发展论坛”由中国半导体行业协会集成电路分会、中国半导体行业协会支撑业分会联合承办，演讲的企业涵盖了与集成电路制造相关的产业链不同环节：以华润上华、卫光科技为代表的半导体制造企业，以华进半导体为代表的装测企业，以北方华创为代表的设备企业，以江丰电子、中巨芯科技为代表的半导体材料企业，将共同探讨产业链协同创新的新模式。

“半导体产业投资与创新论坛”由赛迪顾问、中国电子报社承办，中建投资本、上海集成电路产业投资基金、毕马威、元禾华创、安芯投资、厦门半导体投资集团，以及芯原微电子和基本半导体公司，将对如何进一步促进产融对接进行深入讨论。

“2018 年海峡两岸(上海)集成电路产业合作发展论坛”由上海市集成电路行业协会与 SEMI 台湾主办，台湾半导体产业协会(TSIA)协办。力晶集团、华力、联发科、通富微电、日月光集团、中国 RISC-V 产业联盟，将就两岸进一步推动集成电路产业合作进行探讨。

“RISC-V 创新应用暨开发者论坛”由工业和信息化部软件与集成电路促进中心、中标创新基金管理有限公司、国际 RISC-V 基金会承办，RISC-V 基金会、SiFive 公司、微芯科技公、CORTUS 公司、中天弘宇、华米科技、晶心科技、红帽软件等聚焦广大应用开发者群体，促进 RISC-V 在中国的普及。

龙头企业积极参展 创新成果精彩亮相

作为半导体领域最顶级的展会活动之一，IC China 2018 设立六大展区，包括半导体设计展区、半导体制造封测展区、设备材料展区、创新应用展区、分立器件展区、高端芯片和推广应用展区。目前为止参展企业超过 200 家。

集成电路龙头企业踊跃参展，包括紫光集团、华润微电子、大唐电信等 IDM 企业，中芯国际、华虹宏力、华力、和舰等晶圆代工企业，长电科技、华天集团、通富微电、晶方半导体等封测企业，北方华创、电科装备、中科飞测等设备企业。此外，罗德与施瓦茨、东京精密、住友电木等国际公司以及日月光集团、联发科技等台资公司将在展会现场亮相。

国内外行业协会也积极组团参展。其中韩国企业将首次组团参展，组成韩国展区，展示新产品、新技术。北京、天津、深圳、陕西、南京、厦门、无锡、苏州、成都等地国内各地方行业协会也将组团参展。

从展示内容上看，本次活动全面展示了 IC 设计、IC 设备、封装测试、IC 制造及 IC 材料相关产业的创新成果。紫光集团将展示 32 层 3D NAND 闪存芯片，这是国内首颗拥有完全自主知识产权的三维闪存芯片。紫光展锐将展出 5G 原型机 pilot-v2 平台。半导体装备一直是国内 IC 产业的薄弱环节。

华海清科将展出新型 12 英寸 CMP 设备 Universal -300 plus，该机型采用 Universal-300 机型的成熟技术，集成多种终点检测技术，具备技术水平高、产量高、性能稳定、多单元、多工艺灵活组合等优点。罗德与施瓦茨公司(R&S)将展示针对 5G、IoT 和通用 IC 设计与测试的产品和解决方案。

扫码报名

参会与参观报名



展商报名



联系方式

崔 巍

座机：010-68207449

电话：13910672804

邮箱：misa@ccidexpo.com

王雅静

座机：010-68207449

电话：15801549805

邮箱：wangyj@cena.com.cn

武 剑

座机：010-68208548

电话：18601361052

邮箱：wujian@ccidexpo.com

首届全球 IC 企业家大会暨
第十六届中国国际半导体博览会